



## ローデ・シュワルツとRealtek社、Bluetooth® LE High Data Throughput (HDT) 向けの初めてのテストソリューションを実演紹介

ローデ・シュワルツとRealtek Semiconductors社は、もうすぐ登場するBluetooth® LE High Data Throughput (HDT) 機能に向けた業界初のテストソリューションの検証に成功しました。このローデ・シュワルツのCMP180無線機テストをベースとしたセットアップを、バルセロナで開催のMWC Barcelona 2026とニュルンベルクで開催のembedded world 2026において共同で展示し、Realtek社の次世代Bluetooth®ソリューションであるRTL8922DとRTL8773Jの特性評価を行います。



キャプション：CMP180は、これから登場するBluetooth® LE HDT機能にも対応しています。

ローデ・シュワルツのCMP180は、その高度な機能により、研究開発からプレ・コンFORMANCE試験、量産にまで使える最高のBluetooth®テストソリューションとなっています。このCMP180は、より高い周波帯で今後行われるBluetooth® LEの拡張にすでに対応しており、マルチテクノロジー/マルチデバイス・テストにも最適です。

Bluetooth® LE High Data Throughput (HDT) の機能は、次世代Bluetooth® LEの基盤となる技術です。HDTは最大データレートを2Mbpsから7.5Mbpsに引き上げ、従来のユースケースを大幅に強化するとともに、低遅延オーディオ・ストリーミングや高速なメディア共有、ワイヤレスによるソフトウェア更新の高速化といった新たなユースケースを実現可能にします。技術的な面からすると、このHDT機能は最大4倍の容量増加、優れたエネルギー効率、スペクトラム効率の改善、信頼性の強化などを特徴とします。また、その新しいBluetooth® LE PHYでは、3つの新たな変調方式と異なるレベルの前方誤り訂正を組み合わせることで2~7.5 Mbpsの5段階のデータレートをサポートします。

Realtek社の次世代Wi-Fi/Bluetoothコンボ・チップRTL8922DとBluetoothオーディオ・チップRTL8773Jは、高性能なワイヤレス通信およびオーディオ・プラットフォームのための包括的な基盤を提供するものとなっています。RTL8922Dは、HDT、チャンネル・サウンディング、IEEE 802.15.4を統合した多機能Wi-Fi/Bluetoothコンボ・チップであり、PCやテレビ、ゲーム、自動車、スマートホーム・デバイスなどでWi-Fi、デュアルBluetooth、Zigbee/Threadによる同時接続を可能にします。またRTL8773Jは、Bluetooth Classic、Bluetooth LE、LE Audio、HDTを統合した専用のBluetoothオーディオSoCです。インテリジェントなオーディオ製品に向けて省電力・低遅延の音声処理を実現するとともに、HDTによる伝送で堅牢性と接続性を強化します。

一方、CMP180はWi-Fi 8や5G NR FR1を含めた多くのセルラー系および非セルラー系技術に対応しており、最大500 MHzの帯域幅で8 GHzまでの周波数をサポートします。Bluetooth® LEダイレクト・テストモード (DTM) による制御のほか、チップセット固有のテスト制御機能を介してもBluetooth® LEのテストが行えるうえ、新しいユニバーサル・テスト・プロトコル (UTP) も利用できます。アナライザと信号発生器をそれぞれ2台、そして8つのRFポート2組がワンボックスに統合されています。そのためCMP180は、現在よりもより将来のテストニーズにも応えられる、最新ワイヤレス技術のためのコスト効率に優れたテストソリューションとなっています。

ローデ・シュワルツの無線機テスト担当副社長Goce Talaganovは次のように説明しています。「Realtek Semiconductors社との緊密に連携しながら、新たに登場するBluetooth® LE機能について、その製品ライフサイクル全体に対応できるというCMP180独自の能力を実証できたこと大変感謝しています。当社の無線デバイステストにおける経験に加えて、早くからRealtek社に協力いただいたことで、お客様には業界最高水準のテストソリューションをご提供できるようになりました」。

Realtek Semiconductors社の副社長で広報を担当するYee-Wei Huang 氏も次のように述べています。「Bluetooth LE High Data Throughput は、没入型オーディオやシームレスな接続体験を次なる高みへ押し上げるための重要な要素です。当社のRTL8922D Wi-Fi/Bluetoothコンボ・チップとRTL8773J BluetoothオーディオSoCをローデ・シュワルツのCMP180テストプラットフォームと組み合わせれば、研究開発から量産にいたるまでその性能を実証でき、お客様はHDT対応製品を市場に迅速に投入できるようになります」。

ローデ・シュワルツとRealtek Semiconductors社は、Bluetooth® LE High Data Throughput (HDT) のテストを2つの大きな業界イベントにおいて、ローデ・シュワルツ展示ブースでご紹介します。まずは2026年3月2～5日にバルセロナの展示会場Fira Gran Viaで開催のMobile World Congress 2026におけるホール5・小間番号5A80の当社ブースです。続いて2026年3月10～12日にニュルンベルクで開催のembedded world Exhibition & Conferenceでは、ホール4・小間番号218のローデ・シュワルツ展示ブースに加えて、ホール3A・小間番号325のRealtek社展示ブースでもご覧いただけます。

ローデ・シュワルツのBluetooth®テストソリューションについて、詳しくは<https://www.rohde-schwarz.com/bluetooth>をご確認ください。

[www.rohde-schwarz.com](http://www.rohde-schwarz.com)

#### お問い合わせ：

欧州（本社）：Christian Mokry（電話：+49 89 4129 13052、email：press@rohde-schwarz.com）

北米：Hannah Im（電話：+1 301 957-8357、email：hannah.im@rsa.rohde-schwarz.com）

アジア太平洋地域：Cheyenne Chui（電話：+65 6307 0053、email：press.apac@rohde-schwarz.com）

#### Realtek社について

Realtek Semiconductor Corp.社は、世界をリードするICプロバイダの1社です。通信ネットワーク、コンピュータの周辺機器、マルチメディア・アプリケーションに向けて幅広いIC製品を設計・開発しています。その製品には、10/100/1000 M用Ethernetコントローラ/PHY、10/100/1000 M用Ethernetスイッチ・コントローラ/メディア・コンバータ・コントローラ/ゲートウェイ・コントローラ、無線LANコントローラとAP/ルータSoC、DSLチップ、VoIPソリューション、IoTソリューション、モバイル端末/PC向けのハイ・フィデリティ・オーディオ・ソリューション、クロック・ジェネレータ、カードリーダー・コントローラ、Webカメラ・コントローラ、LCDモニター/ATV/DTVコントローラ、デジタル家電コントローラなどがあります。RFからアナログ、ミックスド・シグナル回路におよぶ高度な設計技術力と強力な生産体制、そしてシステムに関する豊かな知識を基盤として、Realtekは高性能で競争力のあるフル装備のトータルソリューションを提供しています。Realtek社についての詳細は、同社Web社ウェブサイト[www.realtek.com](http://www.realtek.com)をご覧ください。

#### ローデ・シュワルツについて

ローデ・シュワルツは、電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に“つながる”社会の実現に向けて努力を重ねています。グローバルな技術指向のグループとして、90年にわたって先端技術の開発を続け技術の限界を押し広げてきました。当社の最新製品やソリューションは、産業界や規制当局および行政機関のお客様がデジタル技術の主権を得るためのお力添えをしています。ドイツ・ミュンヘンを拠点としたプライベートな独立企業であり、長期的かつ持続的な経営を行える体制を構築しています。ローデ・シュワルツは、2024/2025会計年度（7月から6月）には31.6億ユーロの純収益を上げました。また、2025年6月30日現在、ローデ・シュワルツでは約15,000名の従業員が全世界で活躍しています。

R&S®は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. の登録商標です。

すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、<http://www.press.rohde-schwarz.com>からインターネットでご提供しています。

東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー20階

〒141-0033

関野 敏正

電話番号：+81 3 5925 1270/1290

Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

[www.rohde-schwarz.com/jp](http://www.rohde-schwarz.com/jp)